



中华人民共和国国家标准

GB/T 6618—1995

硅片厚度和总厚度变化测试方法

Test method for thickness and total thickness
variation of silicon slices

1995-04-18 发布

1995-12-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

硅片厚度和总厚度变化测试方法

Test method for thickness and total thickness
variation of silicon slices

GB/T 6618—1995

代替 GB 6618—86

1 主题内容与适用范围

本标准规定了硅单晶切割片、研磨片和抛光片(简称硅片)厚度和总厚度变化的分立点式和扫描式测量方法。

本标准主要用于符合国标 GB 12964、GB 12965 规定的尺寸的硅片的厚度和总厚度变化的测量。在测试仪器允许的情况下,本标准也可用于其他规格硅片的厚度和总厚度变化的测量。

2 引用标准

GB 12964 硅单晶抛光片

GB 12965 硅单晶切割片和研磨片

3 方法提要

3.1 分立点式测量

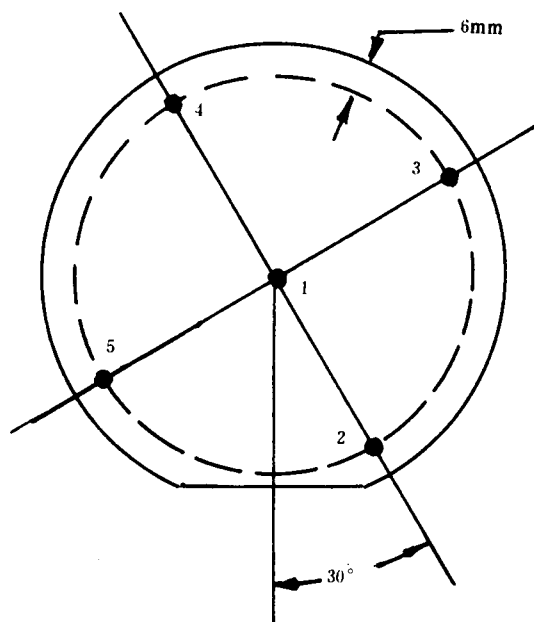


图1 分立点测量方式时的测量点位置